LAGENAUFBAU HDI (Standard)

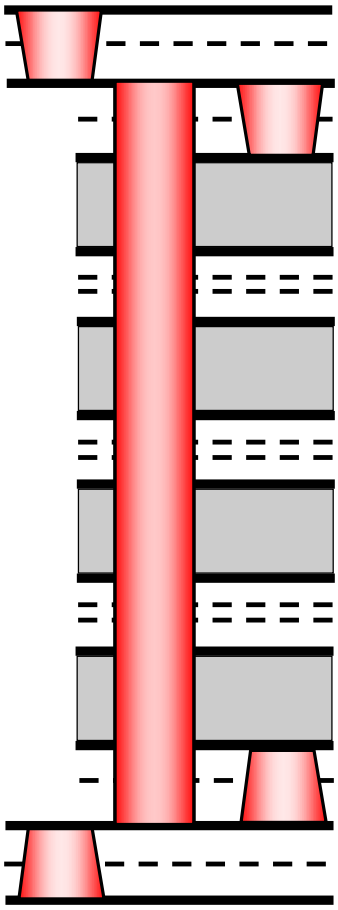
HDI12_2+8(10b)+2_1,25_17.5 — **12 - Lagen**

Kerne: 0,10 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.: — **2 + 8(10B) + 2**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	9 µm		30	
					1 x 1080	66	
3	2			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
4	3			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
5	4			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
6	5			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
7	6			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
8	7			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
9	8			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
10	9			17.5 µm		16	
					1 x 1080	66	
11	RSK1			9 µm		30	
					1 x 1080	60	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1266

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,25**	+/-	0,10	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,34	+/-	0,13	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,40	+/-	0,15	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
29.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	16+